LAGENAUFBAU HDI (Standard)

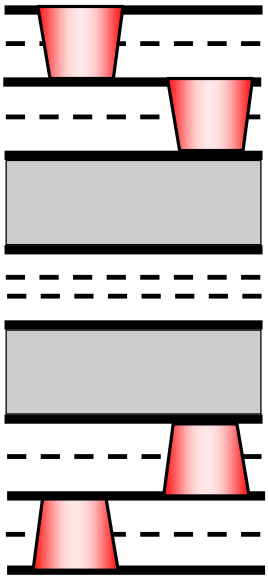
HDI08_2+4+2_1,00_35

8 - Lagen

Kerne: 0,20 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:	**2 + 4 + 2**
KUNDE:	

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	**60**	
2	VSK1		Folie	12 µm		**30**	
					1 x 1080	**60**	
3	2			35 µm		**33**	
			0,200 mm			**200**	
4	3			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**124**	
5	4			35 µm		**33**	
			0,200 mm			**200**	
6	5			35 µm		**33**	
					1 x 1080	**60**	
7	RSK1		Folie	12 µm		**30**	
					1 x 1080	**60**	
8	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 50 µm

Gesamtdicke Material:						980		
Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)								

MATERIALDICKE:	**1,00**	+/-	0,08	mm			Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,08	+/-	0,11	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,14	+/-	0,13	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision		
25.04.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	25.04.2006	R. Schönholz	00	Seite:	10+